

Presseinformation

Mehrfach preisgekröntes System für besonders schnelle Inspektion verdeckter Lötstellen

Hannover, November 2018 – electronica, Halle A3, Stand Nr. 642 – Die Viscom AG hat speziell für die Inline-Röntgeninspektion (3D-AXI) den extrem schnellen Leiterplattentransport xFastFlow entwickelt. Eingesetzt wird diese innovative Lösung im bereits mehrfach preisgekrönten Inspektionssystem X7056-II, das vom 13. bis 16. November auf der Fachmesse electronica in München zu sehen ist.

Die X7056-II von Viscom erfüllt in besonderem Maße die Anforderung von Unternehmen aus der Elektronikfertigung, ein sehr schnelles Handling der Baugruppen mit optimaler Qualitätskontrolle zu verbinden. Zudem lässt sich das Inline-Röntgensystem innerhalb seines bestehenden Gehäuses zu einer kombinierten Lösung mit zusätzlicher automatischer optischer Inspektion (3D-AOI) erweitern. Mit xFastFlow erreicht die Maschine Handlingzeiten (Zu- und Abführung des Prüfobjekts) von bis zu vier Sekunden. Dabei befinden sich bis zu drei Leiterplatten gleichzeitig im 3D-AXI-System.

Für eine erstklassige 3D-Röntgenbildqualität sorgen leistungsstarke Flachbilddetektoren – je nach Konfiguration fest verbaut oder verfahrbar. Mit Hilfe der planaren Computertomografie lassen sich aus den Volumeninformationen sowohl horizontal als auch vertikal Schichtbilder extrahieren, die im Gegensatz zu 2D-Ergebnissen keine störenden Strukturen mehr aufweisen. Man kann z. B. schichtweise ins Innere von BGA-Balls blicken. Fehler wie „Head in Pillow“ bei BGA-Bauteilen oder Voids in Flächenlötungen werden schnell und sicher erkannt. Je nach Anforderung sind Prüftiefe und Durchsatz sowie 3D- und 2D-Inspektion beliebig kombinierbar.

Das Inspektionssystem wird mit der sehr anwenderfreundlichen Viscom-Software vVision bedient und bietet ganz im Sinne von Industrie 4.0 und Smart Factory hervorragende Vernetzungsmöglichkeiten innerhalb

qualitätssichernder Fertigungsprozesse. Die X7056-II hat bereits vier internationale Preise gewonnen: den productronica innovation award 2017 (Inspection & Quality Cluster), den CIRCUITS ASSEMBLY'S 2018 New Product Introduction (NPI) Award (Test & Inspection – AXI), den 2018 SMT China VISION Award (Inspecting & Testing – AXI) und einen ebenfalls 2018 verliehenen EM Innovation Award von Electronics Manufacturing Asia.

Bildunterschriften:

01_Voids können in Lötstellen von LEDs die optimale Wärmeabführung verhindern. Die 3D-AXI-Bildqualität (rechts) überzeugt im Vergleich zu 2D-AXI (links) mit exzellenter Fehler-Erkennbarkeit

02_Die 3D-AXI-Technologie des Systems X7056-II von Viscom sorgt u. a. auch dafür, dass die Erstellung von Prüfprogrammen einfacher wird

Über Viscom

Die Viscom AG entwickelt, fertigt und vertreibt hochwertige Inspektionssysteme. Das Portfolio umfasst die komplette Bandbreite der optischen Inspektion und Röntgenprüfung. Im Bereich der Baugruppeninspektion für die Elektronikfertigung gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern weltweit. Die Systeme von Viscom lassen sich kundenspezifisch konfigurieren und miteinander vernetzen. Hauptsitz und Fertigungsstandort ist Hannover. Mit einem großen Netz aus Niederlassungen, Applikationszentren, Servicestützpunkten und Repräsentanten ist Viscom international vertreten. Gegründet 1984 notiert Viscom seit 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE0007846867). Weitere Informationen: <https://www.viscom.de/>